



Title of Change:	Qualification of DPAK 4 Row Transfer from Cebu to OSV and change in Green Mold compound.
Proposed Changed Material First Ship Date:	01 May 2021 or earlier if approved by customer
Current Material Last Order Date:	01 Feb 2021 <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>
Current Material Last Delivery Date:	30 Apr 2021 <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>
Product Category:	Active components – Discrete components
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Trung.Dang@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Sample Availability Date:	30 Jun 2020
PPAP Availability Date:	31 May 2020
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or ffxg4t@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 12 months prior to implementation of the change or earlier upon customer approval. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com .

Change Category

Category	Type of Change
Test Flow	Move of all or part of electrical wafer test and/or final test to a different location/site/subcontractor
Equipment	Production from a new equipment/tool which uses the same basic technology (replacement equipment or extension of existing equipment pool) without change of process.
Process - Assembly	Move of all or part of assembly to a different location/site/subcontractor., Change of mold compound

Description and Purpose:

This is a Final Change Notification to inform customers of the qualification of DPAK 4 Row transfer from ON Semiconductor Philippines (Cebu) to ON Semiconductor Vietnam (OSV) following changing in mold compound G700HF.

	Before Change Description	After Change Description
Assy and Final Test site	On semiconductor Philippines (Cebu)	On Semiconductor Vietnam (OSV)
Mold Compound	EME660CS (Sumitomo)	G700HF (Sumitomo)



Reason / Motivation for Change:	Capacity improvement
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded. No anticipated impacts.

Sites Affected:	
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
ON Semiconductor Vietnam	None

Marking of Parts/ Traceability of Change:	affected products with this changing will be identified with date code
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: ISL9V3040D3ST (EcoSpark1)
RMS# : V52957
PACKAGE : DPAK

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Ta = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta = 175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175 °C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, deltaTj = 100°C max, Ton = Toff = 2min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A102	130°C, 100% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias = 100V max	1008 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45

QV DEVICE NAME: HUF76629D3ST-SB82250 (UFET PLANAR)
RMS# : V52984
PACKAGE : DPAK

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Ta = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta = 175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175 °C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, deltaTj = 100°C max, Ton = Toff = 2min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A102	130°C, 100% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45



QV DEVICE NAME: FDD2572-F085 (UFET TRENCH)

RMS# : V52981

PACKAGE : DPAK

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Ta = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta = 175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175 °C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, deltaTj = 100°C max, Ton = Toff = 2min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A102	130°C, 100% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias = 100V max	1008 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45

NOTE: AEC-1pager is attached.

To view attachments:

1. Download pdf copy of the PCN to your computer
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field
4. Then click on the attached file/s

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
ISL9V3040D3ST	NA	ISL9V3040D3ST
FDD120AN15A0-F085	NA	FDD2572-F085
FDD14AN06LA0-F085	NA	FDD2572-F085
FDD26AN06A0-F085	NA	FDD2572-F085
HUFA76419D3ST	NA	HUF76629D3ST-SB82250
HUFA76429D3ST-F085	NA	HUF76629D3ST-SB82250
ISL9V2040D3ST	NA	ISL9V3040D3ST

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	セブから OSV への DPAK 4 移管とグリーンモールドコンパウンド変更の認定.	
初回出荷予定日:	01 May 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
現在の材料の最終注文日:	01 Feb 2021 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品)の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。	
現在の材料の最終出荷日:	30 Apr 2021 既存品(変更前品)の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。	
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント - 個別コンポーネント	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Trung.Dang@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	サンプルの注文または PCN.samples@onsemi.com を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。	
サンプル提供開始可能日:	30 Jun 2020	
PPAP 提供開始日:	31 May 2020	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または ffxg4t@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 12 か月前、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前に発行されることがあります。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更希望およびその条件が受諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com にお願います。	
変更カテゴリ:	変更種別	
テスト フロー	電氣的ウエハテストのすべて、一部または最終テスト(あるいはその両方)を異なる場所 / 拠点 / 外注へ移管	
装置	プロセス変更をとみなわない同じ基本技術を使用した新しい装置 / ツール(装置の交換または既存装置の増設)での生産。	
処理 - アセンブリ	組立の全て / 一部の異なる場所 / 拠点 / 外注への移管 モールドコンパウンドの変更	
説明および目的:	これは、モールドコンパウンド G700HF の変更後にオンセミコンダクターフィリピン(セブ)からオンセミコンダクターベトナム(OSV)への DPAK 4 移管の認定をお客様にお知らせする最終変更通知です。	
	変更前の表記	変更後の表記
組立および最終検査拠点	ON Semiconductor Philippine (Cebu)	ON Semiconductor Vietnam (OSV)
モールド・コンパウンド	EME660CS (Sumitomo)	G700HF (Sumitomo)



変更の理由 / 動機:	生産能力向上			
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関する見込まれる影響	製品は同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。製品は認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。 予想される影響はありません。			
影響を受ける拠点:				
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:			
ON Semiconductor Vietnam	無し			
部品の表示 / 変更の追跡可能性:	この変更の影響を受ける製品は、日付コードで識別されます			
信頼性データの要約:				
デバイス名: ISL9V3040D3ST (EcoSpark1) RMS: V52957 パッケージ: DPAK				
テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta = 175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175 °C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, deltaTj = 100°C max, Ton = Toff = 2min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A102	130°C, 100% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias = 100V max	1008 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45
デバイス名: HUF76629D3ST-SB82250 (UFET PLANAR) RMS : V52984 パッケージ: DPAK				
テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta = 175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175 °C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, deltaTj = 100°C max, Ton = Toff = 2min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
UHAST	JESD22-A102	130°C, 100% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45



デバイス名: FDD2572-F085 (UFET TRENCH)

RMS : V52981

パッケージ: DPAK

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta = 175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175 °C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta = +25°C, deltaTj = 100°C max, Ton = Toff = 2min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
UHASt	JESD22-A102	130°C, 100% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias = 100V max	1008 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0/45

注: AEC-1 ページャーが付属しています。

添付文書を見るには:

1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップ アイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルををクリックしま

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号 (既製品) のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メール顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
ISL9V3040D3ST	NA	ISL9V3040D3ST
FDD120AN15A0-F085	NA	FDD2572-F085
FDD14AN06LA0-F085	NA	FDD2572-F085
FDD26AN06A0-F085	NA	FDD2572-F085
HUFA76419D3ST	NA	HUF76629D3ST-SB82250
HUFA76429D3ST-F085	NA	HUF76629D3ST-SB82250
ISL9V2040D3ST	NA	ISL9V3040D3ST



Appendix A: Changed Products

D

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
ISL9V3040D3ST		ISL9V3040D3ST	NA	
FDD120AN15A0-F085		FDD2572-F085	NA	
FDD14AN06LA0-F085		FDD2572-F085	NA	
FDD26AN06A0-F085		FDD2572-F085	NA	
HUFA76419D3ST		HUF76629D3ST-SB82250	NA	
HUFA76429D3ST-F085		HUF76629D3ST-SB82250	NA	
ISL9V2040D3ST		ISL9V3040D3ST	NA	